

证券代码：002156

证券简称：通富微电



通富微电子股份有限公司

（南通市崇川路 288 号）

2026年度向特定对象发行A股股票预案

二〇二六年一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同含义。

1、本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 455,279,073 股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 151,759,691 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 151,759,691 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5、本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 440,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	123,000.00	123,000.00
合计		468,554.30	440,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

7、本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司进一步完善了股利分配政策，关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未来股东回报规划及未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕

31 号) 等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求, 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益, 本预案已在“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”中就本次发行对公司即期回报摊薄的风险进行了认真分析, 并就拟采取的措施进行了充分信息披露, 请投资者予以关注。

公司所制定的填补回报措施不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断, 不构成承诺, 不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容, 注意投资风险。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
目 录	7
释 义	9
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	12
一、发行人基本情况	12
二、本次向特定对象发行股票的背景及目的	12
三、发行对象与发行人的关系	18
四、本次向特定对象发行股票概况	19
五、本次发行是否构成关联交易	22
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	22
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	23
八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序	23
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	24
一、本次募集资金使用计划	24
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	24
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	41
四、本次募集资金使用的可行性分析结论	41
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	42
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况	42
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	43
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	43
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	43
五、本次发行对公司负债情况的影响	44
六、本次股票发行相关的风险说明	44

第四节 公司利润分配政策及执行情况	44
一、公司利润分配政策	49
二、公司最近三年现金股利分配情况	51
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划	51
四、公司最近三年未分配利润使用安排情况	52
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	54
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	54
二、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	54
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示	56
四、本次发行的必要性和合理性	56
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	56
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	59
七、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺	60

释 义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

通富微电、发行人、公司、本公司、上市公司	指	通富微电子股份有限公司
华达集团、控股股东	指	南通华达微电子集团股份有限公司
A股	指	在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	通富微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
本预案	指	通富微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案
AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc.，国际知名的微处理器厂商
AMD苏州、通富超威苏州	指	苏州通富超威半导体有限公司，发行人的控股子公司
AMD槟城、通富超威槟城	指	TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD，发行人的控股子公司
意法半导体、ST	指	ST Microelectronics Pte Ltd.及其关联方，意大利SGS半导体公司和法国汤姆逊半导体合并后的新企业
德州仪器、TI	指	Texas Instruments Incorporated及其关联方，全球领先的模拟及数字半导体IC设计制造公司
联发科、MEDIATEK	指	Mediatek INC.及其关联方，全球著名IC设计厂商
英飞凌	指	Infineon Technologies，全球领先的半导体公司之一
恩智浦	指	恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors N.V.），全球最大的汽车半导体供应商之一
展锐	指	紫光展锐（上海）科技股份有限公司
艾为	指	上海艾为电子技术股份有限公司，A股上市公司，股票代码：688798.SH
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司，A股上市公司，股票代码：300782.SZ
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司，A股上市公司，股票代码：002594.SZ
纳芯微	指	苏州纳芯微电子股份有限公司，A股上市公司，股票代码：688052.SH
封装	指	晶圆制造完成后，通过模拟仿真确定封装设计，将晶圆上的芯片经过凸点制造、减薄、装片、键合/倒装、塑封等一系列工艺，与特定材料整合集成，实现集成电路功能集成，以达

		到保护集成电路、提升集成电路性能的效果
测试	指	晶圆制造完成后或封装完成后，对集成电路的功能、电性能等在不同测试条件下进行检测，以筛选出不合格的产品，并发现集成电路设计、制造及封装过程中的质量缺陷
OSAT	指	半导体委外封装和测试（Outsourced Semiconductor Assembly and Testing）
晶圆	指	多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格，近来发展出12英寸甚至更大规格
芯片	指	广义上指用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件，狭义上指集成电路（IC）
摩尔定律	指	芯片上的晶体管密度，每十八个月到二十四个月，在价格不变情况下，会增加一倍
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）
DRAM	指	动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory），一种易失性半导体存储芯片，是内存模组的存储介质，能够与CPU以及GPU等计算芯片直接交互。在SSD模组中，DRAM主要作为NAND的缓存和索引数据的存储空间。
FLASH	指	一种非易失性存储器
MCM	指	多芯片组件（Multi-chip Module），将多块半导体裸芯片组装在一个布线基板上的封装
LQFP	指	薄型四边引线扁平封装（Low-profile Quad Flat Package）
QFN	指	四侧无引脚扁平封装（Quad Flat No-lead Package）
CSP	指	芯片级封装产品（Chip Scale Package）
SiP	指	系统级封装（System in Package）
BUMP/Bumping	指	硅片凸块封装技术
WLP/WLCSP	指	圆片级封装产品（Wafer Level Packaging/Wafer Level Chip Scale Package），直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再行切割制成单颗组件。
FC	指	倒装型封装（Flip Chip）技术
GPU	指	图形处理器（Graphics Processing Unit），又称显示核心、视觉处理器、显示芯片
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
FCBGA	指	倒装芯片球栅格阵列封装（Flip Chip Ball Grid Array）
FCCSP	指	倒装芯片级封装（Flip Chip Chip Scale Package）
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit）

SoC	指	芯片级系统（System on Chip），意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
BMS	指	电源管理系统（Battery Management System）
ADAS	指	高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System）
I/O	指	输入输出端口（Input/Output），用于设备输入输出信息
BSM	指	背面金属化（Back Side Metallization），在晶圆或芯片的背面沉积金属薄膜的工艺，用于实现导电、散热、焊接等功能
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
注册管理办法	指	上市公司证券发行注册管理办法
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
董事会	指	通富微电子股份有限公司董事会
股东会	指	通富微电子股份有限公司股东会
公司章程	指	通富微电子股份有限公司公司章程
报告期、三年一期	指	2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-9月
最近三年	指	2022年度、2023年度、2024年度
报告期各期末	指	2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

一、发行人基本情况

发行人的基本情况如下：

中文名称	通富微电子股份有限公司
英文名称	TongFu Microelectronics Co., Ltd.
法定代表人	石磊
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	通富微电
股票代码	002156
上市时间	2007 年 8 月 16 日
注册地址	江苏省南通市崇川路 288 号
邮政编码	226006
电话号码	0513-85058919
传真号码	0513-85058929
公司网址	www.tfme.com
电子信箱	tfme_stock@tfme.com
经营范围	研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次向特定对象发行股票的背景及目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家产业政策大力支持集成电路行业发展

近年来，为促进作为国家战略性新兴产业的集成电路产业的健康稳定发展，国家出台了一系列政策，主要如下：

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	主要内容
1	《2024 年政府工作报告》	国务院	2024 年	实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力补齐短板、拉长长板、锻造新

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	主要内容
				板，增强产业链供应链韧性和竞争力。大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
2	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发改委	2023 年	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试。
3	《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局	2023 年	2023 年可享受税收优惠政策的集成电路企业包括集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。
4	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》	国务院	2022 年	深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。
5	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022 年	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。

上述产业政策和法律法规的出台、实施充分体现了公司所属行业及主营业务在国民经济中的重要性地位，一系列政策发布和落实为公司业务的发展提供了良好的经营环境和强有力的政策支持。

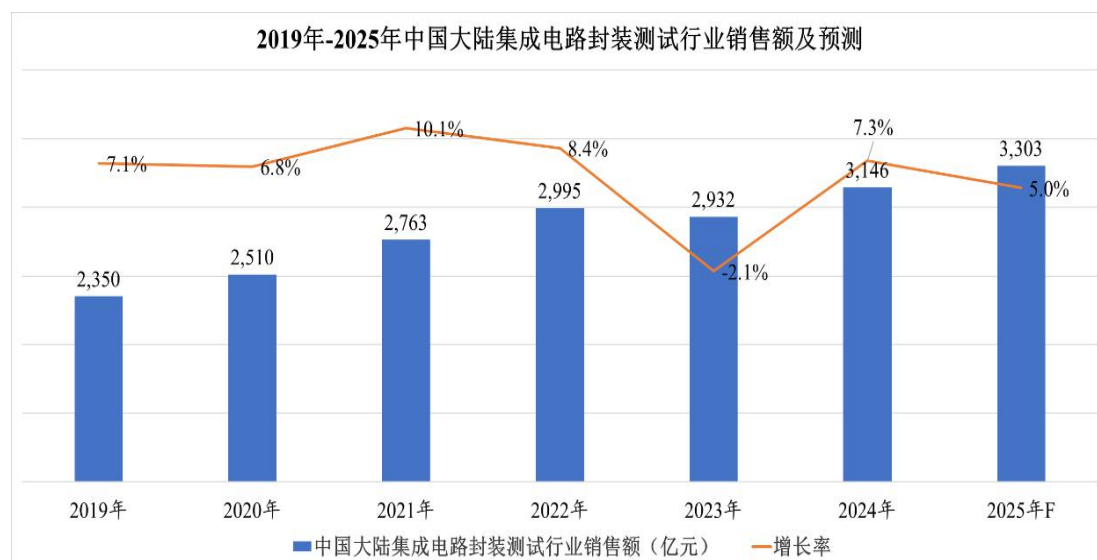
2、产业复苏伴随着新兴下游应用市场需求增长，为集成电路产业未来发展提供了良好的市场前景

集成电路产品是半导体产品中第一大类产品，一直保持着较高的占比，并且多年保持整体上升态势。2024 年以来，人工智能、物联网、5G 通信等新兴技术快速发展，增加了对各类集成电路的需求。同时，消费电子市场回暖，智能手机、

智能可穿戴设备、智能家居等领域出现热点产品，汽车电子领域需求亦持续增长，为集成电路市场提供了广阔空间。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2024 年全球集成电路市场销售额进一步提升至 5,345 亿美元，较 2023 年大幅增长 24.8%。未来，随着人工智能、5G 通信、汽车电子、物联网等新兴市场和应用的快速增长，集成电路市场规模有望继续保持较高的增长水平，赛迪顾问预测 2028 年全球集成电路市场销售额可达 7,217 亿美元，2025 年至 2028 年期间保持 6.3% 的年均复合增长率。

2024 年以来，在全球经济逐步复苏与数字化转型加速的大背景下，受益于国内下游新能源汽车、智能手机等市场拉动，集成电路市场需求量增加，中国大陆集成电路市场规模达 13,738 亿元，同比增长 11.9%。根据赛迪顾问预计，随着终端产品国产化率的不断提升以及终端市场需求的增加，到 2028 年中国大陆集成电路销售额将达到 20,100 亿元，2025 年至 2028 年期间保持 10.2% 的年均复合增长率。

全球集成电路封测市场规模与集成电路市场整体规模的变动趋势基本一致，2024 年，受全球集成电路市场需求回暖的影响，全球集成电路封装业市场规模持续增加，达 743 亿美元，同比增长 11.3%。根据中国半导体行业协会的统计，2024 年中国大陆集成电路封测行业下游需求回暖，先进封装加速发展，产业转移推进，市场规模与竞争力双提升，中国大陆集成电路封测产业销售额达 3,146 亿元，较 2023 年增长 7.3%。



资料来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院

3、先进封装占比逐年上升，成为封测市场核心增长引擎

在摩尔定律放缓背景下，为寻求提升集成电路产品系统集成、高速、高频、三维、超细节距互连等特征，提升芯片集成密度和芯片内连接性能已成为当今集成电路产业的新趋势，先进封装技术能够在再布线层间距、封装垂直高度、I/O 密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案，封装环节对于提升芯片整体性能愈发重要，行业内先后出现了 Bumping、FC、SiP、2D+等先进封装技术，先进封装已经成为后摩尔时代集成电路产业发展的重要途径。

全球先进封装测试占整体封测的比例逐步提高。2024 年，5G、人工智能等催生大量高性能芯片需求，先进封装技术助力集成电路实现高集成度、高散热性，全球先进封装测试业市场规模占整体封测的比例达 44.9%，相对于 2023 年增加 0.4 个百分点。未来，随着传统芯片制程缩小面临物理极限，先进封装技术成为提升芯片整体性能和功能的重要选择，市场规模占比将继续增加。根据预测，2028 年先进封装测试业市场规模占整体封测的比例近 50%，先进封装将为全球封测市场贡献主要增量。

2019 年-2028 年全球集成电路先进封装测试业市场规模及占比



资料来源：Yole Développement、赛迪顾问

4、集成电路产业转移趋势带来新的发展机遇

近年来，中国大陆电子制造业持续发展，国家政策对集成电路产业支持力度不断增强，为产业发展营造了良好环境，全球集成电路产业第三次转移进程明显加速。在制造环节，国际领先晶圆代工企业持续扩大在中国大陆布局，同时，以中芯国际、华虹半导体、晶合集成、粤芯半导体等为代表的本土晶圆制造企业亦积极扩大产能，推动全球半导体制造重心持续向中国大陆集聚。

与之相协同，下游的封装测试产业亦呈现明显的向中国大陆转移的趋势。一方面，源于产业链协同发展的内在需求，随着上游晶圆制造产能的落地和本土芯片设计公司的快速成长，封测环节为贴近市场、优化供应链效率，随之进行区位调整，产业集聚效应日益凸显；另一方面，全球贸易格局变化凸显了供应链安全与自主可控的战略价值，推动国内芯片设计企业将订单转向本土封测企业，以保障产品交付的稳定性和安全性。“国产替代”已超越单一的成本因素，成为驱动封测产业转移的核心动力之一。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、服务于新兴技术发展战略，筑牢本土封测体系与供应安全

本次公司向特定对象发行股票募集资金，主要投向本土关键领域封测产能，全面紧扣国家数字经济和人工智能发展需求。当下，以人工智能、数据中心、自动驾驶、边缘计算等为代表的新一轮技术变革，正推动计算芯片、存储芯片、车载芯片、智能终端主控芯片及通信芯片等关键领域快速扩容。同时，在国际贸易形势与本土供应链安全要求的共同作用下，封测环节亦由过去相对独立的加工环节，升级为“与设计、制造深度协同的本土化生态节点”，承担国产芯片工艺验证、质量闭环及快速量产的关键职责。此外，海外客户也在加速推进 China-for-China 体系，在中国境内构建本地化服务与产能布局以满足市场需求。

本次募投项目均围绕上述关键领域芯片产品及国产替代的战略定位，协同下游头部芯片原厂，加速本土产能建设与供应体系重构，在关键技术节点上形成更具韧性的本土半导体产业链格局。

2、提升产能规模与供给弹性，拓展与下游知名客户的合作

公司是全球半导体封测领域的领先企业，营收规模及市场占有率全球排名第

四、国内排名第二。长期以来，公司的发展与全球及国内半导体产业保持同频，在 AI、高性能计算、移动智能终端、工业控制、车载电子等领域积累了广泛的行业客户基础，包括 AMD、德州仪器、恩智浦、联发科、展锐、艾为、卓胜微、集创北方、比亚迪、纳芯微等。作为产业链关键一环，公司持续推动关键封测能力的升级，通过高良率、高可靠性封测工艺保障下游芯片性能兑现与规模化交付，在重塑全球集成电路制造格局、加速创新技术产业化方面发挥了重要支撑作用。

2024 年以来，半导体行业景气度已逐步回升，人工智能、数据中心、车载电子、边缘计算等新兴技术推进下游应用持续向智能化、集成化的方向迭代，叠加国产替代进程向高端芯片领域深入演进，共同驱动本轮半导体市场强劲的增长趋势。在此背景下，封装测试环节在支撑算力提升、系统集成等方面的作用愈发凸显，已成为新兴技术性能兑现、稳定供给和方案迭代的关键底座之一。封测厂商是否具备充足的产能布局，亦成为头部客户选择合作伙伴、导入新项目的重要考量因素。当前，公司业绩增长情况良好，但现有产能利用率已处于较高水平，难以充分满足既有客户未来新增需求与潜在优质客户的项目导入节奏。

本次公司向特定对象发行股票募集资金，主要投向下游高景气度、国产替代加速、技术密集的增长领域，提升现有产能规模与供给弹性，以更好地承接下游市场复苏及结构性增长机遇，为国内外龙头客户提供更稳健的本土化封测支撑，并为承接新兴优质客户奠定产能基础，巩固公司在全球封测产业的领先地位。

3、优化产能结构，匹配下游技术及市场发展的趋势

作为行业龙头企业，公司已形成较为完备的封测能力体系及多元下游应用布局。本次募投项目以现有封测平台为基础，通过对存储、车载、晶圆级封测、高性能计算与通信等关键细分领域的产能布局，实现在做大存量的同时做优结构，提升公司面向高端化产品的封测实力，助力后摩尔时代芯片性能与系统能力的持续跃升。

具体而言，本次募投项目整体侧重于面向下游高端芯片产品，实现对高性能及高可靠性产品的封测能力提升，加强对应封装能力体系的建设与协同。其中，“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”主要针对经典封装形式在高可靠性场景的应用，扩建符合车规标准的封装产能，同时加强高端芯片的测试验证能力；

“存储芯片封测产能提升项目”主要针对 FLASH、DRAM 存储产品，提升符合高堆叠、高可靠性要求的存储封测产能，满足下游终端对高速及高容量的发展趋势；“晶圆级封测产能提升项目”、“高性能计算及通信领域封测产能提升项目”则以先进封装工艺为主，加强从前端晶圆级 Bumping 到后端芯片 FC、SiP 等一体化技术布局，满足下游芯片高算力、高集成度、轻薄化的演进方向，为客户提供一站式高端封测解决方案。

本次募投项目将夯实公司在高端封测领域的综合竞争力与战略地位，推进公司产品结构从“广覆盖”向“强支点”的升级，匹配下游技术及市场的发展趋势。

4、增强公司资金实力，促进公司业务稳步发展

公司所处集成电路封测行业为资金密集型行业，技术研发创新、生产运营、产品市场推广及相关服务都需要大量的资金持续投入。近年来，发行人销售收入持续增长，随着经营规模的扩大，原材料采购等资金占用增加，发行人流动资金的需求日益显著。充足的流动资金，有利于发行人进行合理的资金配置，保障发行人经营规模的持续较快增长。

通过本次向特定对象发行，有利于促进公司业务稳步发展；有利于提高公司偿债能力，降低财务杠杆与短期偿债风险；有利于公司降低财务费用，提高公司盈利水平。在公司业务规模不断扩大的背景下，补充流动资金及偿还银行贷款可以对公司业务发展提供有力支持，改善公司的财务结构、减少财务风险。

三、发行对象与发行人的关系

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据

竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行竞价结束后的相关公告中予以披露。

四、本次向特定对象发行股票概况

（一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式与发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

（三）发行对象、与发行人的关系

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 455,279,073 股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 151,759,691 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 151,759,691 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行

对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

（六）限售期

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 440,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	123,000.00	123,000.00
合计		468,554.30	440,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以

自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

（八）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易。

（九）滚存利润分配安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

（十）本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,517,596,912 股，石明达通过华达集团间接控制公司 19.79%的股份，为公司实际控制人。

若假设本次发行股票数量为发行上限 455,279,073 股，则本次发行完成后，预计华达集团持有的公司股份比例将下降至 15.22%，其余股东持股较为分散，华达集团仍为上市公司的控股股东，石明达仍为上市公司的实际控制人。同时，

本次发行方案中约定，单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的 10%（含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认购。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序

本次发行已经由公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会作出同意注册的批复。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

在完成上述审批手续之后，公司将择机向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 440,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金投入
1	存储芯片封测产能提升项目	88,837.47	80,000.00
2	汽车等新兴应用领域封测产能提升项目	109,955.80	105,500.00
3	晶圆级封测产能提升项目	74,330.26	69,500.00
4	高性能计算及通信领域封测产能提升项目	72,430.77	62,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	123,000.00	123,000.00
合计		468,554.30	440,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

二、项目方案概述及必要性、可行性分析

公司基于对半导体产业趋势的洞察与自身产能版图的评估，持续提升和优化自身封测产能，选择具备战略价值、市场景气度高、符合技术演进方向、确定性强的项目作为资本投入及产能升级的主轴，为境内外客户提供专业可靠的封测解决方案，巩固公司在产业链中的核心支撑作用。

在必要性方面，下游人工智能、新能源汽车、移动智能终端、物联网等领域的技术变革与升级，叠加半导体领域国产替代的持续推进，正持续催生对相关芯

片的大规模封测需求。公司产线整体保持较高产能利用率，产能瓶颈逐步显现。本次募投项目以现有产业化封测平台为基础实施产能提升，针对上述行业发展趋势，重点围绕存储芯片封测、车载芯片封测、晶圆级封测以及面向高性能计算与通信芯片的封测能力进行布局，在扩充产能规模的同时优化产品与工艺结构，提升公司面向高端化产品的封测实力。本次募投项目匹配下游芯片高算力、高可靠性、高集成度的发展趋势，有助于公司在“技术变革”与“国产替代”浪潮叠加背景下把握市场发展机遇，更好满足下游客户需求，支持后摩尔时代芯片性能的持续跃升。

在可行性方面，公司具备丰富的技术储备和客户基础，不涉及面向全新的技术研发或开拓全新的市场风险，具备实施本次募投项目能力。公司建有国家级和省级的高层次创新平台，承担多项国家级科技攻关项目，拥有一支专业的研发队伍，已成功切入主流的高端封测领域并持续进阶。在坚实技术的基础上，公司主动融入全球半导体产业链，积累了国内外市场开发的经验，充分理解不同市场及客户群体的要求，并针对行业前沿的需求进行产品开发。公司已在不同细分领域积累了广泛的头部客户资源，形成长期稳定的合作关系。

关于本次募投项目的具体情况分析，内容如下：

（一）存储芯片封测产能提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 88,837.47 万元提升存储芯片封测产能，项目建成后年新增存储芯片封测产能 84.96 万片。本项目实施将有助于公司进一步扩大生产规模、优化产品结构、增强抗风险能力，巩固并增强公司在存储封测领域的优势地位。

2、项目投资的必要性

（1）响应自主可控的战略目标，推进存储芯片领域国产替代

半导体产业作为现代工业体系的核心支撑，其自主可控能力已上升为国家战略重点。近年来，国家密集出台《国家集成电路产业发展推进纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等多项政策文件，强调要围绕集成电路等重点领域开展全链条关键核心技术攻关，

并持续从资金、人才等方面系统发力，推动产业基础高级化和产业链现代化，为国产替代创造了良好的政策和市场环境。

在上述政策与下游需求共振的背景下，存储芯片作为信息基础设施的“底座”，同时又是我国半导体产业的相对短板，成为半导体领域国产替代的重点方向之一。存储芯片具有较高的技术壁垒，体现在速率与容量、堆叠层数、先进制程与可靠性管理等方面，长期以来由美、日、韩等海外厂商主导。随着下游应用领域对高带宽、高容量、高可靠性存储的需求快速上升，国内市场形成了稳定且持续扩大的“增量+国产替代”空间。近年来，以长江存储、长鑫存储为代表的本土企业围绕堆叠层数、制程节点、控制器与固件算法优化等方向持续投入，具备了在重点应用领域实现规模化国产替代的技术与产业基础。公司加快建设和提升面向存储芯片的本土封测产能与技术，亦是保障国产存储芯片稳定供给和大规模导入应用场景的关键一环。

（2）把握下游市场的快速发展机遇，提升存储封测产能

2024 年以来，全球半导体市场整体景气度显著修复，AI、智能终端、新能源汽车等领域的持续扩张为存储市场带来增长动能，成为带动行业复苏的主要引擎。

存储芯片作为数据密集型系统的核心支撑，其在服务器、PC、智能手机、汽车电子等多个场景中渗透率持续提升。在 AI 大模型推理及边缘侧智能化发展带动下，市场对高带宽、高容量、高可靠性的存储产品需求快速上行。同时，传统应用如个人电脑、手机等产品亦呈现出更新迭代快、结构性升级的趋势，推动存储市场在价格与比特总量两个维度同步增长。上述因素共同导致 2025 年以来存储市场供不应求的局面。在此背景下，国产厂商亦加速导入 3D NAND、DDR5、LPDDR5 等先进产品，形成放量趋势，对配套封装工艺能力、量产效率提出了更高要求。

综上，本土封测企业正迎来覆盖存储芯片全产品线的新增需求窗口。本募投项目通过提升存储芯片的封测产能，有助于公司把握下游市场的快速发展机遇，提升营收规模及盈利水平。

（3）优化公司产能布局，强化存储关键领域的封测能力

公司作为国内领先的半导体封装测试服务企业，已具备覆盖市场主流封装技术及多元化应用领域的综合服务能力，并与各主要下游龙头客户建立了长期稳定的合作关系。基于对当前行业趋势的系统研判以及对自身产能结构的全面评估，公司本次募集资金投资项目将聚焦于成长性突出、确定性较强的重点方向，包括围绕存储芯片等高景气领域的封测需求，规划进行产线扩建与技术能力升级。

项目实施后，公司将在承接现有核心客户新增需求的基础上，进一步强化关键应用场景中的交付能力，提升在存储等战略性下游市场中的服务深度与响应能力，巩固并扩大公司在核心封测环节的技术领先优势与行业竞争地位。

3、项目实施的可行性

（1）下游市场空间对本项目可行性的保障

在全球存储市场层面，产业周期与终端需求共振显著。受益于服务器、个人电脑、智能手机等核心计算平台出货回暖与容量升级趋势，存储芯片市场规模快速扩张，并在 AI 浪潮驱动下呈现新一轮需求爆发与技术迭代的双重上升周期。

根据 Techinsights 统计，存储芯片市场在经历了 2023 年的“去库存周期”后，2024 年迎来反弹，市场规模达到 1,704.07 亿美元，同比增长 77.64%，2024-2029 年的年均复合增长率为 12.34%；根据中研普华产业研究院，2024 年中国存储芯片市场规模达 4,600 亿元，预计 2025 年将突破 5,500 亿元，年复合增长率保持 20%左右。

（2）技术储备及产业化经验对本项目可行性的保障

在存储领域，公司存储芯片封测能力伴随中国存储半导体产业自主发展同步成长，以晶圆减薄与高堆叠封装能力为核心技术，业务范围已全面覆盖 FLASH、DRAM 中高端产品封测，能够满足大容量、高速度、高堆叠、高可靠性等多维度要求，并与领军企业建立了长期稳定合作关系，形成了完备的量产验证和产业化经验。同时，公司围绕下游市场与客户的升级需求，持续深耕超厚金属层晶圆处理、高堆叠处理、高可靠性产品解决方案等关键工艺，取得良好的技术积累。

本募投项目主要是在既有工艺平台和量产经验基础上的产能提升与结构优化，面向的下游产品需求增量显著、发展确定性高，不涉及全新工艺路线的大规模开发。依托公司在存储芯片封装工艺平台、产品导入和客户端协同方面的既有优势，公司具备在较短周期内实现新增存储芯片封测产能爬坡与充分消化的能力，从而为本次存储芯片封测产能提升项目的可行性提供了坚实支撑。

4、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为通富通科（南通）微电子有限公司，实施地点为南通市崇川区通京大道 226 号。

5、项目建设期

本项目建设周期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目计划投资总额 88,837.47 万元，其中拟投入募集资金 80,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	设备购置费	80,188.26	80,000.00
2	建设单位管理、试运行、环保、培训等费用	254.00	-
3	预备费	600.00	-
4	铺底流动资金	7,795.21	-
合计		88,837.47	80,000.00

7、项目涉及的报批事项

本项目已取得南通市崇川区数据局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号为“崇数据备[2025]655 号”。本项目环评尚未办理完毕，公司正在执行相关环评工作，环评材料正在编制过程中。

（二）汽车等新兴应用领域封测产能提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 109,955.80 万元提升汽车等新兴应用领域封测产能，项目建成后年新增汽车等新兴应用领域封测产能 50,400 万块。本项目实施将有助于公司进一步调整产品结构、扩大生产规模、增强抗风险能力，巩固并增强公司在车载等封测领域的优势地位。

2、项目投资的必要性

（1）顺应车载电子国产化趋势，提升高可靠封测保障能力

在半导体应用领域中，车载领域对应的芯片类型多样，普遍面临工作环境复杂、生命周期长、对可靠性与功能安全标准极高等挑战，属于国产芯片渗透的难点领域。头部主机厂过往倾向选择验证体系成熟、量产经验丰富的海外厂商，导致车载芯片国产化起步相对较晚、推进节奏更为审慎。

当前，在新能源汽车、智能座舱与自动驾驶等新一代汽车电子需求快速扩张的背景下，叠加国内半导体设计与制造能力持续提升，车载芯片国产替代逻辑正由“政策推动”逐步演变为“市场驱动”。一方面，终端厂商出于供应链安全、交付稳定性、成本管控以及本地协同效率等多重考虑，主动加大对国产车规芯片的验证与导入力度，从非核心的辅助类器件逐步延伸至车载 MCU、SoC、BMS 等环节；另一方面，国内厂商在产品可靠性设计、车规认证体系（如 AEC-Q 标准）、量产质量管控等方面加速追赶，可替代产品的性能指标与应用场景不断向中高端延伸，国产芯片与主机厂之间的协同开发也日趋常态化，形成了“本土需求—本土供给”相互强化的良性循环。

面向车载等对芯片性能及可靠性要求较高的应用场景，芯片封测能力亦是确保产品性能稳定、信号完整与长期可靠的关键环节。本募投项目拟提升汽车等新兴应用领域封测产能，实现满足车规标准的封装产线扩产，加强高端测试能力的布局，积极响应国家政策及战略目标，为半导体国产化浪潮提供重要保障。

（2）把握下游市场的快速发展机遇，提升车载封测产能

车载芯片的增长，核心逻辑来自整车电动化、电子电气架构升级、智能化配置渗透的同步推进。一方面，较传统汽车而言，新能源汽车显著增加了单车在控制、电池管理、传感器、功率传输等环节的芯片用量；另一方面，整车电子电气

架构正由分布式向域控制、集中式演进，催生 MCU、SoC、车载以太网、车规存储等高性能芯片需求，叠加智能座舱、辅助驾驶乃至高阶自动驾驶功能的普及，使得计算、控制及通信类芯片在更多车型上加速渗透。在此背景下，国内整车厂及 Tier1 厂商持续导入国产方案，叠加部分海外客户基于“China for China”的策略引导，车载芯片的封测产能和验证体系亦持续向境内转移。上述因素共同作用，推动车载芯片市场在中长期保持稳健增长，亦推动市场对车载芯片高可靠性封测产能的需求提升。

综上，本土封测企业正迎来覆盖车载芯片全产品线的新增需求窗口。公司相关产能的利用率已处于较高水平，本募投项目通过提升车载芯片的封测产能，把握下游市场的快速发展机遇，提升营收规模及盈利水平。

（3）优化公司产能结构布局，加强针对高性能及高可靠性产品的封测能力

本项目立足公司既有 QFN、LQFP 等经典封装外型，面向汽车电子等对性能及可靠性要求较高的新兴应用场景，在“经典封装+车规标准”的方向上进行结构性升级。一方面，在封装工艺端引入更严格的材料选型、过程控制等要求，使成熟封装工艺更好地适配车规领域所面对的复杂工况；另一方面，在测试环节构建覆盖电性能测试、宽温区测试、老化测试、系统级测试等在内的多维度高标准验证体系，通过更高的测试覆盖率与质量追溯能力，全面提升车规及其他高性能、高可靠性产品的一致性和稳定性。

综上，本项目新增产能主要面向车载等高标准、高可靠性领域布局，强化高端产品的封测能力，优化公司产能结构，更好满足下游车规等高标准产品的封测需求。

3、项目实施的可行性

（1）下游市场空间对本项目可行性的保障

当前，全球汽车产业正经历“电动化、智能化、网联化”的变革，新能源汽车市场呈现爆发式增长。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量已由 2019 年的 120.6 万辆提升至 2024 年的 1,286.6 万辆，新能源汽车的市场占有率已超过 40%，2022 年到 2024 年我国新能源汽车市场年均销量增长率超过 36%。

随着新能源汽车渗透率的提升，市场对汽车芯片的需求量也大幅提升。以车规 MCU 为例，智能化的发展趋势推进车载芯片功能的复杂度提升，MCU 在智能座舱、车身控制、车载娱乐等基础系统的应用基础上，目前已广泛延伸至动力控制、底盘域及 ADAS 等高安全性、高实时性的关键功能模块，对 MCU 的算力、接口能力、功能安全等级提出更高要求。随着电动车与智能汽车渗透率提升，单车 MCU 价值量亦显著提升。

基于上述发展趋势，近年来车载芯片市场规模快速提升。根据 Omdia 的数据和预测，2024 年全球车规级半导体市场规模约为 721 亿美元，2025 年将达到 804 亿美元，增长率为 11.51%；2024 年中国车规级半导体市场规模约为 198 亿美元，2025 年将达到 216 亿美元，增长率为 9.09%。

（2）技术储备及产业化经验对本项目可行性的保障

公司在汽车电子封装测试领域深耕多年，较早即导入并通过符合全球汽车行业主流标准的质量管理体系认证。自 2005 年顺利通过 ISO/TS16949 质量体系认证以来，公司持续按照车规要求优化生产及质量控制流程，形成覆盖研发、生产、测试及供应链管理的全流程质量管理体系。依托上述体系基础，公司在车载芯片温度范围宽、工作寿命长等特殊应用要求下，持续精进封测工艺与质量控制能力，已实现满足 AEC 规范中 Grade 0 等高可靠性等级要求的高端汽车电子产品封装，为本次进一步拓展车载芯片封测产能奠定了坚实的体系与经验基础。

依托在车规产品领域长期积累的技术优势与质量口碑，公司已成为车载芯片本土化封测的重要参与者，具备面向车载芯片产品的解决方案能力，并与多家海内外头部企业形成稳定合作关系。公司在车规领域多年的产品验证与客户协同开发经验，使其能够更好理解车载芯片对功能安全、可靠性验证及生命周期管理的综合要求，在新项目导入、样品验证、大批量生产等环节与客户形成高效协同。

综上，本募投项目定位于在既有技术平台和量产经验基础上的车载芯片封测产能扩张与结构优化，主要面向下游需求增长趋势明确、国产替代空间广阔的产品领域，不涉及全新、未经验证工艺路线的大规模开发。

4、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为通富通科（南通）微电子有限公司，实施地点为南通市崇川区通京大道 226 号。

5、项目建设期

本项目建设周期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目计划投资总额 109,955.80 万元，其中拟投入募集资金 105,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	设备购置费	105,545.90	105,500.00
2	建设单位管理、试运行、环保、培训等费用	254.00	-
3	预备费	600.00	-
4	铺底流动资金	3,555.90	-
合计		109,955.80	105,500.00

7、项目涉及的报批事项

本项目已取得南通市崇川区数据局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号为“崇数据备[2025]656 号”。本项目环评尚未办理完毕，公司正在执行相关环评工作，环评材料正在编制过程中。

（三）晶圆级封测产能提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 74,330.26 万元提升晶圆级封测等产能，新增晶圆级封测产能 31.20 万片，同时亦提升该厂区高可靠性车载品封测产能 15.732 亿块。本项目实施将有助于发行人扩大晶圆级封装等先进封装实力，促进公司向下游客户提供完整解决方案，优化产品结构，进一步增强公司在行业中的竞争力及影响力。

2、项目投资的必要性

（1）顺应下游技术发展趋势，加强晶圆级先进封装布局

晶圆级封装作为先进封装的重要技术方向，已成为满足高性能芯片高频化、轻薄化、小型化趋势的关键工艺路径。其核心工艺在于以晶圆整体为封装单元，在晶圆尚未切割前完成凸块形成（Bumping）、重布线（RDL）、晶圆测试、封装成型等关键步骤，属于对前段晶圆制造环节的延伸。相较引线焊接等传统封装形式，晶圆级封装通过上述所形成的凸块，缩短芯片到外部电路的连接距离，并通过优化互联材料，显著降低了寄生电感、电容及信号延迟，提升了信号传输速度与稳定性，并在封装尺寸、互联密度、信号完整性、热管理能力等方面具备明显优势。作为关键技术环节，晶圆级封装亦是其他诸多先进封装工艺的前序步骤，在先进封装产业中具有重大意义，可实现多场景的协同与互补。

公司本次加强晶圆级封装能力建设，系基于对先进封装技术演进趋势的系统判断，有助于公司构建长期支撑先进计算、高速接口、小型器件封装需求的技术优势，提升面向头部客户的协同设计、交付能力与技术服务深度，进一步夯实在高端封测领域的战略卡位。

（2）把握下游高端市场的快速发展机遇，提升晶圆级封测产能

随着 AI、数据中心、自动驾驶、移动智能终端、可穿戴设备等应用场景的持续拓展与升级，芯片的算力需求及功能复杂度同步提升，对封装形式在电气性能、I/O 密度、体积控制及散热能力等方面提出更高要求，推动晶圆级封装技术加速渗透。在同等芯片面积和功耗约束下，晶圆级封装支撑更高工作频率、更大带宽和更多功能模块集成，已成为下游高性能芯片的关键封装方案之一。

晶圆级封装是多种先进封装技术的重要工艺基础，因此天然具备跨芯片品类、跨下游行业、广泛适配的特征。目前，晶圆级封装已应用于 AI 芯片、CPU、GPU、存储芯片、智能主控芯片、通信芯片、电源管理芯片等诸多核心领域。在产品升级迭代加速以及对单位芯片性能/体积比要求持续提升的背景下，晶圆级封装已由传统的消费类移动终端，逐步向高性能计算、服务器、工控与车规场景、可穿戴设备等多元终端形态快速拓展，成为下游客户重点关注和布局的先进封装路线之一。

公司本次聚焦晶圆级封装的产能建设，将有助于把握下游客户对高性能、小型化封装方案的迫切需求，承接下游高端产品订单量的提升，进一步巩固公司在

先进封装细分市场中的响应能力和客户渗透率。

(3) 优化公司产能结构布局，提升综合解决方案供应能力

本次募投项目的晶圆级封装平台可涵盖 Cu Pillar 铜柱、Solder Bump 焊料凸点、BSM 背面金属化等关键技术单元，覆盖各类数字芯片与模拟芯片在高速、低功耗、高密度封装方面的结构化需求，并可灵活适配多种封装形式及下游应用场景。

同时，晶圆级封装具备显著的“平台效应”，可作为车载芯片封装、存储芯片封装、倒装封装、系统级封装等多条工艺路线的前序支撑。通过本次项目实施，公司将构建贯通不同封装工艺的协同平台，形成从前端凸块工艺（Bumping）到后端封装成型的一体化衔接能力，提升为客户提供 Turnkey 全流程封装解决方案的服务能力。未来，公司可基于不同客户产品架构及量产节奏，为其定制化设计从晶圆级封装到高级异构集成的产品路径，进一步强化公司作为封测综合解决方案提供商的技术厚度与客户粘性。

3、项目实施的可行性

(1) 下游市场空间对本项目可行性的保障

以晶圆级封装为代表的主流先进封装技术，所面向的下游应用领域较为多元，以下主要围绕当下需求增量迅猛以及国产替代加速推进的高性能计算领域以及移动智能终端领域进行分析。

随着 AI 时代的到来，市场对算力的需求大幅提升，具备超强计算能力和卓越性能的各类逻辑芯片实现快速发展。根据弗若斯特沙利文预测，到 2029 年，中国的 AI 芯片市场规模将从 2024 年的 1,425.37 亿元激增至 13,367.92 亿元，2025 年至 2029 年期间年均复合增长率为 53.7%。在此过程中，中国 AI 芯片市场亦在加速推进国产化，在外部限制性政策以及国家数据安全与信息安全需求的共同驱动下，本土芯片厂商持续突破知识产权与关键技术壁垒，完善软硬件协同的国产生态系统。AI 芯片市场的扩张与国产化进程的演进，为先进封装技术的规模化应用提供了明确的下游牵引。

先进封装技术还可以应用于以智能手机为代表的移动智能终端，并发挥着日

益关键的作用，覆盖主控 SoC、通信芯片、电源管理芯片等多个核心品类。手机作为通信与信息入口，是重要的交流连接工具。根据 IDC 统计数据，2020-2024 年全球智能手机年均出货量为 12.4 亿部，2024 年到 2029 年全球智能手机出货量将保持 1.6% 的复合增长率，全球智能手机所在的电子消费市场有望迎来复苏。随着端侧大模型、AI 助手等应用加速向智能手机渗透，手机正由传统的通信工具加速演进为个人化 AI 终端，促进主控 SoC 及配套芯片的加速迭代。除手机以外，全球智能穿戴设备正处于快速增长期，市场发展潜力巨大。根据 Precedence Research 数据，2024 年全球智能穿戴设备市场规模约为 721 亿美元，预计 2034 年将增长至 4,317 亿美元，从 2024 年至 2034 年的复合年均增长率为 19.59%。在终端数量稳健增长的同时，智能移动终端中核心芯片的国产替代趋势亦持续演进，为国内封测产业提供了广阔的市场空间。

（2）技术储备及产业化经验对本项目可行性的保障

公司的晶圆级封装能力主要系针对市场更高阶、更薄型产品的需求，构建起多层次 Bumping、WLCSP 等技术布局。公司可提供 8/12 英寸的圆片级封装服务，技术能力覆盖 Cu Pillar 铜柱、Solder bump 焊料凸块、BSM 背面金属化、WLCSP 圆片级芯片尺寸封装等，具有稳定的高封装良率。公司持续根据下游晶圆级封装开发需求，推进新材料和工艺的研发工作，建立差异化竞争力，为晶圆级封装产品线的可持续发展和中高端国产化替代提供具有前瞻性的封装解决方案。

本募投项目主要系基于原有业务的产能提升项目，面向的产品亦是确定性高的晶圆级封装芯片，不涉及全新技术的开发。公司已有的技术储备及产业化经验是对本项目可行性的重要保障。

4、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为通富微电子股份有限公司，实施地点为南通市崇川区崇川路 288 号。

5、项目建设期

本项目建设周期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目计划投资总额 74,330.26 万元，其中拟投入募集资金 69,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	设备购置费	69,968.93	69,500.00
2	建设单位管理、试运行、环保、培训等费用	254.00	-
3	预备费	600.00	-
4	铺底流动资金	3,507.33	-
合计		74,330.26	69,500.00

7、项目涉及的报批事项

本项目已取得南通市崇川区数据局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号为“崇数据备[2025]657 号”。本项目已取得南通市崇川区数据局出具的关于本项目环境影响评价表的批复，批复文件号为“崇数据批[2026]2 号”。

（四）高性能计算及通信领域封测产能提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 72,430.77 万元用于提升高性能计算及通信领域封测产能，项目建成后年新增相关封测产能合计 48,000 万块。本项目有助于公司优化产品结构，提升公司的经营规模及盈利能力，进一步巩固在先进封测领域的优势。

2、项目投资的必要性

（1）顺应下游技术发展趋势，加强倒装及系统级先进封装布局

高性能计算及通信领域封测产能提升项目主要涉及倒装封装（Flip Chip）与系统级封装（System-in-Package，SiP）等先进封装技术。随着下游芯片应用场景不断向高性能、高集成、高带宽方向演进，传统封装形式在互连密度、散热能力、系统集成效率等方面已难以满足新一代芯片在算力密度、电气性能与封装尺寸等方面的综合需求。倒装与系统级封装作为当前主流的先进封装架构，已成为支撑

人工智能、高性能计算、5G 通信、边缘计算、移动终端和车载智能化等前沿应用的重要技术路径。

具体而言，倒装封装通过芯片正面朝下与基板直接互联，省去传统引线键合结构，显著缩短信号传输路径、降低寄生电感与串扰，提高信号完整性与传输速率，同时支持更高 I/O 数量及更大封装面积，具备优良的热性能与电气性能，特别适用于高算力、高频、高速芯片的封装需求，广泛应用于 AI 加速芯片、CPU、GPU、网络通信芯片、主控 SoC 芯片等产品。

系统级封装则面向下游芯片“小型化+多功能集成”的需求趋势，通过在同一封装体内集成多颗芯片或有源/无源器件，形成功能完整、体积紧凑的微系统封装单元，可在有限空间内实现复杂信号处理、射频收发、存储、功率等多功能协同工作，显著提升系统集成度与终端产品的性能稳定性。SiP 广泛应用于通信领域，如射频芯片等，涉及移动智能终端、可穿戴设备、物联网设备等典型终端场景，特别是在 5G 等无线通信技术推进下，其结构优势与市场渗透率持续提升。

基于上述技术趋势及市场需求情况，公司拟通过本募投项目进一步扩展倒装及系统级封装的产能布局，完善面向高性能、高密度、多集成应用场景的先进封装体系，提升对下游市场产品升级转型的支撑能力。

（2）把握下游高端市场的快速发展机遇，提升高性能计算及通信芯片封测产能

在高性能计算领域，以人工智能、高速计算与数据传输为代表的新型应用正在重塑全球半导体需求结构，芯片架构正加速向高频率、高带宽、高 I/O 密度、高能效比方向演进，对封装工艺在集成度、散热能力与信号传输效率等方面提出更高要求。倒装封装已成为 CPU、GPU、主控 SoC 等高性能芯片的主流封装方案。随着数据中心、个人电脑、移动智能终端、物联网终端等场景的落地与升级，高性能芯片的出货量和结构复杂度持续上升，带动倒装封装的市场空间快速扩张。

在通信领域，以 5G 为代表的新一代移动通信技术叠加消费电子升级，正推动射频前端架构持续演进。随着 5G 频段数量增加、MIMO 架构普及以及天线模组复杂度提升，射频通道数大幅增加，传统分立芯片加板级集成方案在空间占用、

功耗控制和信号完整性方面日益受限。在此背景下，系统级封装逐步成为射频器件的主流集成路径，通过在封装内部集成射频收发、滤波、功放、开关及匹配网络等多类器件，不仅提升封装与装联效率，也有利于整体优化电磁兼容性和射频信号完整性。目前，SiP 封装在智能手机中的应用已日益成熟，并在智能手表、TWS 耳机、智能家居、健康监测等可穿戴及泛 IoT 场景中保持快速渗透，呈现出技术路径可复制、应用需求多样化的特征。

本募投项目将精准把握下游高端市场的结构性放量机遇，强化公司在倒装与系统级封装产品线的响应速度与交付能力，为公司未来订单承接与客户拓展提供关键支撑。

（3）优化公司产能结构布局，强化公司针对主流先进封装服务的供应能力

公司自 2016 年通过对 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权的并购，成功完成从传统封装向高端先进封装的战略转型，并逐步构建起可覆盖高性能计算、网络通信、图像处理及主控 SoC 芯片等关键领域的封测能力体系。公司全资子公司南通通富微电子有限公司定位于 FC、SiP 等前沿方向的技术研发与产能建设，服务于国内外龙头客户的定制化封测需求，同时积极支持国产芯片高端化演进的浪潮。

本募投项目在延续公司既有优势基础上，将进一步扩充本土高端先进封装的核心产线，重点提升公司在高 I/O 封装、高散热结构、高密度互连布线、多芯片集成等技术维度的封测能力，夯实面向高性能计算及通信领域的交付能力。通过本项目的实施，公司将提升在高技术壁垒、高可靠性封测服务中的综合能力，巩固其在国内外先进封装主赛道中的核心竞争力与产业话语权。

3、项目实施的可行性

（1）下游市场空间对本项目可行性的保障

请参见本节之“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（三）晶圆级封测产能提升项目”之“3、项目实施的可行性”。

（2）技术储备及产业化经验对本项目可行性的保障

公司是国内较早布局先进封装领域的封测企业，近年来亦持续在 FC、SiP 等主流先进封装不断进阶，满足下游产品高端化的需求。在倒装封装方面，公司具备 FCCSP 和 FCBGA 等封装技术，可满足 CPU、GPU 等品类芯片对高带宽、低延迟的封装方案需求，亦可满足移动智能终端、边缘 AI 设备的紧凑型计算及控制芯片需求。公司已具备和国内外龙头客户的长期合作经验，不断提升先进封测领域的实践经验，并围绕材料创新、工艺升级、可靠性提升等方面进行研发，为下游客户提供行业内领先的封测方案。在系统级封装方面，公司产品可支持不同制程/材料的芯片，为下游龙头客户提供行业领先的小型化方案，以满足下游多芯片集成的发展趋势。

本募投项目主要系基于原有业务的产能提升项目，面向的产品亦是增长趋势显著、确定性高的芯片，不涉及全新的工艺开发。公司已有的技术优势和客户基础是对本项目可行性的重要保障。

4、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为南通通富微电子有限公司，实施地点南通市苏锡通科技产业园区江达路 99 号。

5、项目建设期

本项目建设周期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目计划投资总额 72,430.77 万元，其中拟投入募集资金 62,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	设备购置费	62,364.76	62,000.00
2	建设单位管理、试运行、环保、培训等费用	254.00	-
3	预备费	600.00	-
4	铺底流动资金	9,212.01	-
合计		72,430.77	62,000.00

7、项目涉及的报批事项

本项目已取得江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号为“苏锡通行审备[2025]208 号”。本项目已取得江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局关于本项目环境影响评价表的批复，批复文件号为“通苏锡通环复（表）[2025]33 号”。

（五）补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目基本情况

发行人综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟使用募集资金中的 123,000.00 万元补充流动资金及偿还银行贷款。

2、项目投资的必要性

（1）公司业务规模持续增长，营运资金需求增加

报告期内，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大。随着经营规模的扩大，原材料采购等资金占用增加，公司流动资金的需求日益显著。充足的流动资金，有利于公司进行合理的资金配置，保障公司经营规模的持续增长。

（2）有助于改善公司的财务结构，提高抗风险能力

报告期内，为缓解公司业务发展带来的资金压力，公司以向银行贷款的方式进行了融资，截至 2025 年 9 月末，公司合并报表资产负债率为 63.04%。本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于缓解公司发展过程中的资金压力；有利于提高公司偿债能力，降低财务杠杆与短期偿债风险；有利于公司降低财务费用，提高公司盈利水平。在公司业务规模不断扩大的背景下，本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，可以对公司业务发展提供有力支持，改善公司的财务结构、提高抗风险能力。

3、项目实施的可行性

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉

第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的有关规定，方案切实可行。

同时，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境，能够保证募集资金的规范使用。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。实施本次募集资金投资项目是优化公司产能水平及结构布局，提升公司持续创新能力，实现公司业务升级的重要举措，随着募投项目建成后带来的技术提升及产品优势，公司的经营业绩和盈利能力将得到提升，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将有所增长，整体财务状况将得到提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，为公司业务的长期持续发展提供良好的保障。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向特定对象发行股票有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构 **和业务结构的变化情况**

（一）本次发行对公司主营业务及资产的影响

公司本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，有利于提升公司的技术水平和市场竞争力，从而更好地满足市场和客户需求。本次发行完成后，公司的主营业务不变，不涉及对公司现有资产的整合，不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，本次发行不会对公司章程造成影响。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股东结构及持股比例将发生一定的变化。本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

（四）本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成重大影响。截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，募集资金将用于公司主营业务以及补充流动资金和偿还银行贷款，公司业务结构不会发生重大变化。本次募集资金拟投入项目将进一步夯实公司现有主营业务，优化公司产能结构布局，增强公司的市场竞争力，从而提升公司的盈利能力。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，资产状况将进一步优化。本次发行将有利于公司降低财务风险、增加资金实力、优化财务结构。

（二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司股本总额将增加，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标存在被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。

从中长期来看，本次募集资金投资项目系依据公司业务需求及发展战略等因素综合考虑确定，具有良好的市场前景，有助于公司提升核心竞争力，巩固行业地位，亦有利于公司长期盈利能力的提升。

（三）对公司现金流量的影响

本次募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流量将有所增加，资金实力将得到明显提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，满足公司的战略发展需求。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次向特定对象发行完成后，公司实际控制人保持不变，公司与控股股东及实际控制人以及其他企业之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，公司与控股股东及实际控制人以及其他企业之间的关联交易不会发生重大变化。此外，本次发行亦不会导致公司在业务经营方面与控股股东及实际控制人以及其他企业之间新增同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联

人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业违规提供担保的情形。公司亦不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业占用以及为其违规提供担保的情况。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司的资产负债结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强。

六、本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

（一）市场风险

1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场波动给公司带来的经营风险。

2、产业政策变化风险

集成电路作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。政府对加快发展集成电路产业十分重视，制定并实施了一系列的产业扶持政策，例如《关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》《国家集成电路产业发展推进纲要》等。政府对集成电路行业的产业政策为我国业内企业提供了良好的政策环境，扶持了国内集成

电路封装测试企业。若国家产业政策发生不利变化，将对行业产生一定的影响。

同时，公司产品最终销往国外的占比较高，虽然国家为鼓励和促进集成电路产业的发展制定了涉及进出口、财政税收以及投融资等一系列优惠政策，但是如果国家产业政策、进出口政策或者公司产品进口国家或地区的相关政策、法规或规则等有所调整，可能会对公司的业务造成不利影响。另外，公司控股子公司通富超威槟城在马来西亚设有工厂，该等国家产业政策变化也将会对公司业务运营产生影响。

（二）经营风险

1、境外市场及国际贸易风险

公司作为封测代工企业，从产业链角度受贸易争端影响较小。未来，如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，限制进出口或提高关税，公司可能面临设备、原材料短缺和客户流失等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生一定影响。

2、主要原材料、设备供应风险

公司产品生产所需主要原材料为引线框架、基板、键合丝和塑封料等未来，如果原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，或者因供货商供货不足、原材料质量问题等不可测因素影响公司产品的正常生产，对公司业绩产生一定影响。

集成电路封装测试行业对设备有较高要求，部分重要核心设备在国内的合格供应商数量较少，需要依靠进口。未来，如果公司的重要核心设备发生供应短缺，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦或外交冲突进而影响到相应设备的出口许可，可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。同时，公司本次募集资金投资项目所需的设备部分需要进口，如果设备供应商所在国家的贸易政策发生变化，公司所需设备无法正常采购，将会影响公司募集资金投资项目的实施进度，进而对募投项目的投资收益产生不利影响。

公司持续与国内及国际知名原材料供应商开展合作，关注对应国产设备的发展进展，并在技术可行范围内推进国产设备的验证工作，做好潜在替代方案的技

术与工艺储备。

3、客户集中度较高的风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司来自前五大客户的收入占比分别为 68.90%、72.62%、69.00%和 69.73%，占比相对较高。

公司控股子公司通富超威苏州及通富超威槟城原系 AMD 下属专门从事封装与测试业务的子公司，主要用于承接 AMD 内部的芯片封装与测试业务。公司 2016 年完成对通富超威苏州及通富超威槟城的收购后，将其从 AMD 的内部封测厂商转型成为面对国内外具有高端封测需求客户开放的 OSAT 厂商。近年来，公司来自 AMD 及其他客户的订单量均有较大幅度的增长；但从客户收入占比角度看，短期内 AMD 依然是公司的第一大客户。

若今后 AMD 经营状况出现较大变动，导致 AMD 自身对于封装及测试的需求量减少，则公司将由于客户集中度高而面临经营波动的风险。对此，公司将继续加强与境内外领先的知名半导体企业合作，积极努力发展其他客户，降低对 AMD 的业务占比。

（三）财务风险

1、汇率风险

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，公司出口销售收入占比分别为 72.24%、74.36%、66.01%和 67.54%，以外币结算收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

2、商誉减值风险

公司收购通富超威苏州和通富超威槟城属于非同一控制下的企业合并，其合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。截至 2025 年 9 月 30 日，公司确认的商誉金额为 118,130.26 万元，占公司合并口径总资产的比例为 2.60%。根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。尽管通富超威苏州和通富超威槟城整体目前盈利状况

较好，但不排除由于行业整体波动、国际环境变化等因素导致其经营状况出现恶化，导致收购形成商誉减值，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、业绩下滑的风险

集成电路封装测试在集成电路芯片制造产业链中属于后道产业链环节，其生产和技术开发通常需要紧跟上游制造的发展趋势，并与下游应用需求热点相匹配。而集成电路行业具有技术更新快、前沿应用频出、下游行业需求不断提升的特点，因此公司业绩很大程度上受下游行业的景气度影响。而且近年来受半导体行业的周期性波动、中美贸易摩擦、市场竞争加剧等因素影响，公司经营业绩出现了一定波动，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月公司归属于母公司股东的净利润分别为 50,183.25 万元、16,943.85 万元、67,758.83 万元、86,049.11 万元。若未来下游行业需求减弱、市场竞争加剧以及公司未能及时跟上集成电路行业的市场与技术变化趋势，则公司可能出现业绩下滑的风险。

（四）本次发行相关风险

1、审批风险

截至本预案公告日，本次发行方案已获得公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所的审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。能否通过以上机构审批以及审批通过的时间具有不确定性。

2、发行风险

公司将在取得证监会注册批复后向特定对象发行股票，发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。本次向特定对象发行存在发行募集资金不足的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

发行人对本次募投项目的选择是在充分考虑了行业发展趋势、公司发展战略以及公司自身的技术、市场、管理等因素的基础上确定的，发行人已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，但由于项目的实施不可避免的会受到国内外宏观经济环境、同行业市场竞争格局、上下游行业状况、国家产业政策、募集资金到

位时间等多种因素的影响，如果该类因素发生不可预见的负面变化，本次募投项目将会存在无法达到预期效益的风险。

（五）其他风险

1、股价波动风险

本次向特定对象发行将对发行人的生产经营及财务状况产生一定影响，本次向特定对象发行完成尚需要一定周期且存在诸多不确定性因素。在本次向特定对象发行方案推动与执行过程中，可能存在由于投资者预期、股票二级市场环境、公司基本面等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动。

2、控股股东股权质押风险

截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东华达集团持有公司 30,034.47 万股，占公司总股本的 19.79%。华达集团质押的股份共计 4,381.00 万股，占公司总股本的比例为 2.89%。目前，控股股东华达集团财务状况、信用状况良好，除控股股东外，发行人不存在其他 10%以上股东，总体而言质押风险可控，因质押而导致控制权变更的可能性较小。若未来由于宏观经济形势变化、行业竞争加剧、发行人控股股东及公司经营状况不佳或者现金流周转状况变差等因素导致发行人控股股东无法履行或者无法足额履行有关到期债务，相关质押股份存在被处置的风险，可能导致发行人控股股东的持股比例发生变化。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据深圳证券交易所的相关要求,《公司章程》规定了公司的利润分配政策,最新的公司章程中有关利润分配政策具体条款如下:

(一) 公司的利润分配形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 公司现金形式分红的条件

- 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 3、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

(三) 公司现金形式分红的比例与时间间隔

在满足现金分红条件时,最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的公司可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

- 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
- 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、股本情况等提议进行中期利润分配。

（四）公司发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）公司利润分配的决策机制与程序

公司利润分配预案由公司经营层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，由独立董事对提请股东会审议的利润分配预案进行审核并发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

分红预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

（六）公司利润分配政策调整的决策机制与程序

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不

得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东会批准时，公司同时应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

二、公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于上市公司股东的净利润	67,758.83	16,943.85	50,183.25
现金分红金额（含税）	6,829.19	1,821.12	14,678.39
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	10.08%	10.75%	29.25%
最近三年年均可分配利润	44,961.98		
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例	51.89%		

三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

公司未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划如下：

（一）公司的利润分配形式

公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在满足《公司章程》规定条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、股本情况等提议进行中期利润分配。

（二）公司现金形式分红的条件

在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司未来三年（2026-2028 年度）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。采用股利进行利润分配的，应充分考虑股票股利分配后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。

由于国内半导体行业正处于发展及转型期，为了抓住半导体行业发展契机，满足市场需求，提高自身竞争力，公司未来需要进一步调整产品结构，持续投入较大资金进行设备改造、扩产以及技术开发。为了确保公司能够长期健康、稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。

（三）公司利润分配的决策机制与程序

公司的利润分配方案由公司总裁拟定后提交公司董事会审议。公司董事会应按照既定的利润分配政策和实际的经营情况制定各年的利润分配方案，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。

公司因未满足《公司章程》规定的现金分红条件达不到上述利润分配比例，或不进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明原因，同时说明公司未分配利润的用途和使用计划，经独立董事发表意见后提交股东会审议。

（四）分红回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见进行修订，在公司董事会审议通过后提交公司股东会审议。

未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。

调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东会，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金

及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于支持公司正常的生产经营活动，助力公司进一步提升市场份额，提升公司核心竞争力和盈利能力。

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求等情况，除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展情况需要股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）分析的主要假设和前提

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行股票于 2026 年 6 月 30 日实施完毕。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行股票数量上限为 455,279,073 股，若公司在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。

4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司已披露的《通富微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》，公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 86,049.11 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 77,800.82 万元。假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为上述 2025 年 1-9 月已实现金额的 4/3，分别为 114,732.14 万元及 103,734.43 万元。

假设公司 2026 年度，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润与 2025 年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降 10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长 10%。

（二）本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了 2026 年度不同净利润增长假设条件下本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	151,759.69	151,759.69	197,287.60
本次发行股份数量（万股）			45,527.91
假设情形一：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年减少 10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	114,732.14	103,258.93	103,258.93
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,734.43	93,360.98	93,360.98
基本每股收益（元/股）	0.76	0.68	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.68	0.62	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.68	0.59
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.68	0.62	0.53
假设情形二：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2025 年持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	114,732.14	114,732.14	114,732.14
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,734.43	103,734.43	103,734.43
基本每股收益（元/股）	0.76	0.76	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.68	0.68	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.76	0.66
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.68	0.68	0.59

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
假设情形三：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年增加 10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	114,732.14	126,205.36	126,205.36
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,734.43	114,107.87	114,107.87
基本每股收益（元/股）	0.76	0.83	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.68	0.75	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.83	0.72
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.68	0.75	0.65

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

三、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

四、本次发行的必要性和合理性

本次融资的必要性和合理性详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来战略布局展开，公司有望通过实施本次募投项目进一步扩大经营规模，优化产能结构，增强核心竞争力。具体而言，本次募投项目主要是在公司原有产品线的基础上进一步提升封测产能，并侧重于投向符合下游国产替代以及新兴技术发展趋势、市场需求快速增长的应用领域。一方面，随着政策的驱动、下游需求的持续扩张以及国产替代加速，以存储和车载为代表的 key 应用领域对封测环节的本地化、稳定供给提出了更高要求，龙头客户亦持续释放产能需求，增长态势显著，公司将围绕存储、车载等应用领域，提升相关封测能力；另一方面，下游芯片不断朝着轻薄化、算力提升与系统集成的技术方向演进，尤其是 AI 技术的发展，推动高性能计算、网络通信、高端消费/工业/汽车等领域的高速发展，公司将进一步提升晶圆级封装、倒装封装、系统级封装等主流先进封测工艺的产能，为客户提供完整解决方案，巩固自身在高端封测领域的领先地位，支持后摩尔时代芯片性能与系统能力的持续跃升。此外，本次募投项目还包括补充流动资金及偿还银行贷款，有助于增强公司资金实力，促进公司业务稳步发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备

公司深刻认识到，构建结构合理、层次分明的人才梯队，是驱动持续创新的关键动力源。基于这一核心认知，公司持续强化人才梯队的系统化建设，不仅面向社会招募经验丰富的行业精英，更积极通过优化校园招聘、深化校企合作等方式，精准发掘和吸纳具有创新潜力的新生力量，确保人才来源的多样化和梯队结构的完整性，为公司发展注入强大且可持续的创新动能。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司研发人员共计 2,615 人，占公司员工总数的比例为 10.75%。公司核心技术研发团队稳定，具有较强的技术优势。公司持续为实现中长期战略目标而吸纳专业人才的计划不仅为公司快速发展积累了充足的人才储备，也能够有效保障项目的顺利实施。

2、技术储备

公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省集成电路先进封装测试重点实验室、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系，并聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，持续进行关键方向及先进技术的开发，取得了丰硕的技术创新成果，例如，大尺寸多芯片 Chiplet 封装取得重要优化进展，通过改进封装结构设计和材料工艺，成功提升了封装密度、散热性能和整体可靠性；FCCSP SOC 电容背贴产品通过考核并进入量产；存储芯片上持续加强高堆叠、定制化材料、超厚金属层切割控制等关键方向的技术升级。

公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计专利申请量突破 1,700 件，其中发明专利占比近 70%；累计授权专利超 800 项，形成了涵盖传统封装和先进封装的全方位知识产权保护网络，为公司高质量发展注入创新动能。同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。

公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。广泛的产品布局优势，有利于实现多元化增长动能，有效对冲行业周期性波动风险。

3、市场储备

公司以超前的意识，主动融入全球半导体产业链，积累了多年国内外市场开发的经验，使得公司可以更了解不同客户群体的特殊要求，进而针对其需求进行产品设计并提供相应高质量的服务，与主要客户建立并巩固长期稳定的合作关系。公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业。从全球市场来看，大多数世界前 20 强半导体企业都已成为公司客户；从国内市场来看，公司陪伴国内客户共同成长与壮大，已和国内大多数知名集成电路企业保持良好的合作关系，包括与车载、存储等关键赛道的领军企业建立了长期深度的业务往来。综上，公司在国际、国内市场形成了较为充分的客户储备，为公司封测能力迭代提供了强劲的需求牵引。

近年来，在“顾客满意第一”的战略指引下，公司各部门通力合作，梳理从承诺到执行的运作机制，全面提升产品竞争力与客户服务水平，口碑赞誉日隆，公司荣获德州仪器、恩智浦、联发科、展锐、艾为、卓胜微、集创北方、比亚迪、纳芯微、ABOV、中科蓝讯等超过 30 家客户的嘉奖，荣获圣邦微、杰华特、思瑞浦、帝奥微、极海半导体等客户针对公司产品线、销售、工程、质量、交付等团队及个人近百件表彰。

此外，通过并购，公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是 AMD 最大的封测供应商，占其订单总数的 80%以上，未来随着大客户业务的成长，上述战略合作将使双方持续受益。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规

范性文件的要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司的《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。

公司将严格按照上述规定管理本次募集资金,对募集资金实行专户存储,专款专用,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金按照约定用途得到充分有效利用,防范募集资金使用的潜在风险。

(二) 稳步推进募集资金投资项目建设,提高资金使用效率

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来发展规划,有利于扩大公司的业务规模,提高公司的综合竞争力。在募集资金到位后,公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入,并提高资金的使用效率,确保募集资金投资项目能够按期建设完成并实现预期收益。

(三) 落实利润分配政策,强化投资者回报机制

公司按照相关法律法规的规定,在《公司章程》中明确和完善公司利润分配的原则和方式,完善公司利润分配的决策程序和机制,建立健全有效的股东回报机制。未来,公司将严格执行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,切实保护公众投资者的合法权益。

(四) 加强经营管理和内部控制,提升经营效率

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,持续优化业务流程和内部控制制度。未来公司将进一步提高经营和管理水平,完善并强化经营决策程序,全面有效地提升公司经营效率,控制公司经营风险。

七、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

(一) 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司的全体董事、高级管理人员作出承诺如下:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益；

3、本人承诺将对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺接受由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、自本承诺函出具之日起至本次发行实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿/赔偿责任。

9、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：

“1、本单位/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本单位/本人承诺督促公司切实履行填补被摊薄即期回报的措施；

3、自本承诺函出具之日起至本次发行实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不

能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

4、本单位/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿/赔偿责任。

5、作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位/本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本单位/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

通富微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日